



日時：2017年7/12(水)18:00～7/13(木)17:00

開催場所：パナソニックリゾート大阪 大阪府吹田市青葉丘南10-1 ▶ 06-6877-0111

・本ワークショップは恒例の聴講者参加型を特徴としています。  
 ・ワークショップの醍醐味である異分野、競合を超えた技術者間の交流の場を重視し、各業界の著名な先生方をナイトセッション講師にお招きし、実装関連技術の将来像を語って頂きます。事前希望で振り分けた各講師毎のグループで議論して頂けます。

**\* ナイトセッション(1日目) 「実装技術で異分野を接合」**

講師6名のショート講演の後、各講師グループに分かれて討議。事前希望でグループ分け

今田真嗣 半導体実装開発部 室長	株式会社デンソー	『パワー半導体 実装技術の方向性』
佐野健志 教授	山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンター	『スマート未来ハウスで目指す快適で健康な生活』
清川 肇 代表取締役社長	清川メッキ工業株式会社	『小さいモノへのめっき』
横山周史 代表取締役社長	株式会社リプロセル	『再生医療の未来予想図』
八木良樹 代表取締役社長	マイクロニクス株式会社	『再生医療の自動化システムの課題』
西村哲郎 代表取締役社長	株式会社日本スペリア社	『高い接合信頼性をサポートする接合技術』

\* 事前申し込みの方々には、一緒に語り明かしたいナイトセッション講師を選択頂けます。

**\* ワークショップ(2日目)**

横山周史 代表取締役社長	株式会社リプロセル	『iPS 細胞から広がる医療の未来』
今田真嗣 半導体実装開発部 室長	株式会社デンソー	『車載半導体製品 デンソーの実装技術 放熱、耐熱へのアプローチ』

**\* ポスターセッション 44件(予定)**

●3Dインテグレーション

- 「コンプレッションモールド技術が切り開く FOWLP/PLP」
- 「ファインピッチ Cu-Pillar bump NCF 工法の開発」
- 「2.1D パッケージ用薄膜プロセスの微細化技術」
- 「薄化大面積 Si デバイスのレイアウト依存の変形と反りのシミュレーション」

●カーエレクトロニクス・パワーエレクトロニクス

- 「Cu-NiO 混合ナノ粒子による無加圧接合」
- 「インテグレートッドインテリジェントパワーモジュールの開発」
- 「熱硬化イミド型ナノコンポジット材料の高耐熱パワー半導体への応用」
- 「次世代半導体高温ダイアタッチの劣化過程の解析」
- 「焼結促進溶剤の開発～次世代型パワーデバイス実現に向けて～」
- 「3D-MID の実用化に向けた高効率なはんだリフロー技術」

●接合・インターコネクト

- 「N2 環境下での焼結を可能とする加圧・加熱接合装置及び量産装置の提案」
- 「CuSn 合金めっきをもちいた接合技術の開発」
- 「低価格・高信頼性を有する無銀鉛フリーはんだの開発」
- 「3元組成のSACめっき、及び低融点から高融点はんだめっきのご提案」

●基板・パッケージ、部品内蔵

- 「熱アシストプラズマ処理を用いたフッ素樹脂と配線材料との革新的接着技術」
- 「薄膜キャパシタ内蔵基板「GigaModule-EG」の開発状況」
- 「LSI パッケージにおける高放熱材料の適用検討(仮)」
- 「3D実装デバイスMIPTEC」

●めっき

- 「湿式法による TGV 付きガラス基板への直接めっき膜形成法」
- 「高温接合部用 無電解 Ni-P/Cu めっき処理の検討」
- 「低温浴無電解 Ni-P めっき液の開発」
- 「はんだ濡れ性・耐高温性に優れたパワーデバイス用新規無電解ニッケルめっき液「ICP ニコロン LPD-LF」」

- 「被覆厚みを制御した溶融スズめっき工法の開発と電子部品応用」

●新材料・ナノペースト

- 「ミストデポジション法による薄膜事業展開」
- 「ポリイミド電着による複雑形状部品の絶縁塗装」
- 「無電解銅めっき触媒用銀ナノ粒子の開発」
- 「低温導体化銅ペースト」
- 「実装材料に適用可能な高耐熱性樹脂の開発」

●フレキシブルエレクトロニクス

- 「有機絶縁材料に対する銅密着性向上技術」
- 「プリンテッドエレクトロニクスに向けた樹脂硬化型導電性ペーストの開発」
- 「真空紫外平行光を用いた微細配線形成技術」

●MEMS、バイオ、医療

- 「道路インフラモニタリングセンサ端末の低温封止実装技術の開発」
- 「MEMS・センサーチップ実装・気密封止技術」

●製造装置関係

- 「Aqua Plasma(r)(水蒸気プラズマ)による銀および銅電極の還元処理」
- 「真空封止装置、表面活性化接合装置」
- 「回転レーザービームによる精密微細加工」
- 「内部加工型レーザーダイシング技術の最新動向」

●環境、評価

- 「新規 RoHS 規制物質フタル酸エステル類の分析について」
- 「新規 1 液フラックス洗浄システム」
- 「Na 二次電池用 Sn 系合金負極の電析(仮)」
- 「微弱発光検出法による樹脂材料の酸化劣化評価」

●オプトエレクトロニクス・マシビジョン

- 「高速 C-MOS カメラとその応用技術」
- 「シリコン基板上への 16ch(4ch×4)集積レーザーアレイ光源の実装」
- 「ハイブリッドボンディング(仮)」

TOWA(株)	岩田 康弘氏
サンユレック(株)	野口 一輝氏
新光電気工業(株)	新井 理絵氏
(株)富士通研究所	土手 暁氏
(株)豊田中央研究所	佐藤 敏一氏
三菱電機(株)	中島 泰氏
(株)日本触媒	杉岡 卓央氏
(株)日産アーケ	山下 真理氏
(株)ダイセル	藤井 寛之氏
テクノアルファ(株)	大下 貴久氏
アルファデザイン(株)	白鳥 俊幸氏
メテック(株)	檜山優莉香氏
(株)日本スペリア社	竹中 悠真氏
(株)新菱	西 弘敏氏
大阪大学	大久保雄司氏
富士通インターコネクトテクノロジー(株)	飯島 和彦氏
日立化成(株)	福住 志津氏
パナソニック(株)AIS 社	小林 充氏
江東電気(株)	高山 昌敏氏
(株)クオルテック	大矢 怜史氏
(株)クオルテック	西森 太樹氏
奥野製薬工業(株)	長谷川典彦氏
昭和製線(株)	廣瀬 康輔氏
(株)FLOSFIA	井川 拓人氏
(株)シミズ	水島 正博氏
DIC(株)	米澤 憲正氏
日立化成(株)	深倉 元氣氏
堺化学工業(株)	宮田 篤氏
四国化成工業(株)	勝村 真人氏
京都エレックス(株)	松原 豊治氏
ウシオ電機(株)	細谷 茂治氏
NMEMS 技術研究機構	原田 武氏
(株)イングスシナノ	島田 照男氏
サムコ(株)	寺井 弘和氏
アユミ工業(株)	阿部 英之氏
(株)片岡製作所	中芝 伸一氏
浜松ホトニクス(株)	鈴木那津輝氏
(株)タツタ環境分析センター	野村 泰之氏
化研テック(株)	神保 拓郎氏
大阪府立大学	清本 雅貴氏
東北電子産業(株)	豊永 匡仁氏
コーデンシ(株)	吉田 昌史氏
光電子融合基盤技術研究所	西沢 元亨氏
東北大学	発表者調整中

参加費 ●前泊2日間コース (会員) 30,000円  
(非会員) 35,000円

- \* ウェルカムレセプション
- \* ナイトセッション
- \* 宿泊費
- \* 2日目ワークショップ参加費 (昼食費は含まれません)

●日帰り1日コース (会員) 20,000円 (非会員) 25,000円  
〔2日目ワークショップ参加費のみ (昼食費は含まれません)〕

\*申し込みは開催10日前まで受け付けますが、トータル100名になり次第締め切らせて頂きます。  
\*会員価格は、JIEP会員ならびに協賛団体会員の方を対象といたします。

参加申込み: エレクトロニクス実装学会ホームページ <https://web.jiep.or.jp/kansai/event.html> よりお願いいたします。

予定

7/12 (水)

15:00~18:00 チェックイン (自由時間)  
18:00~20:00 レセプション (立食パーティー)  
20:00~21:00 ナイトセッション1部 (講師6名のショート講演)  
21:00~22:00 ナイトセッション2部 (各講師毎のグループへ分かれて討議)  
22:00~ ナイトセッション3部 (各講師6部屋へ移動 自由集合)



レセプション

7/13 (木)

8:00~ 8:45 モーニングセッション  
8:45~ 9:00 オリエンテーション (2日目日帰りコースの参加)  
9:00~10:00 ポスター アブストラクト トーク  
10:00~11:00 講演会 第1部  
11:00~12:00 講演会 第2部  
12:00~13:00 昼休憩  
13:00~16:50 ポスターセッション  
16:50~17:00 閉会

モーニングセッション



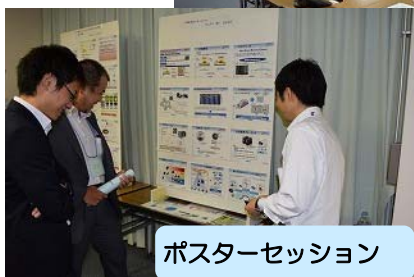
ナイトセッション

ナイトセッション集合写真

関西ワークショップ2016@琵琶湖



講演会



ポスターセッション



宿泊

自由時間

交通機関



最寄駅 大阪モノレール宇野辺駅からリゾート大阪まで徒歩約8分 (シャトルバスもごさいます)

[https://phio.panasonic.co.jp/resort/r\\_osaka/index.htm](https://phio.panasonic.co.jp/resort/r_osaka/index.htm)

主催 エレクトロニクス実装学会 関西支部 【問い合わせ先】 E-mail: ws-kansai@jiep.or.jp

- 協賛: 日本ロボット工業会 (JARA)、日本電子回路工業会 (JPCA)、溶接学会マイクロ接合研究委員会、表面技術協会関西支部
- 応用物理学会関西支部、日本機械学会関西支部、日本材料学会関西支部、日本金属学会関西支部、高分子学会関西支部、電気学会関西支部
- 電子情報通信学会関西支部、日本接着学会関西支部、日本信頼性学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会

\*発表テーマは仮題とします。講師、内容に変更になる場合があります。また、ご希望のセッションやポスターが選定されない場合もありますので予めご了承下さい。